软件手动检测Mask（光罩板）的流程如下：

1.手动上下料

 ⚫ 点击unload，stage运动到接料位置

 ⚫ 摆放Mask（光罩板），点击load ，stage 移动到检测位

2. 相机参数设置

⚫ 设置TDI黑白相机的照明和聚焦点

⚫ 设置回拍彩色相机参数（比如光强、曝光值、聚焦点）

3. 训练（Train）——识别晶圆上die尺寸和数量的过程，最终创建出一个标准die

⚫ scan and stitch wafer： 扫描和拼接整个晶圆

⚫ Click zero die Top Left：选择视窗内的中心 die 的左上角，作为0 号 die 标志

⚫ Learn die size：框选一个完整 die的轮廓

⚫ Build golden die ：创建标准 golden die

4. 检测缺陷参数设置

5. 缺陷检测（Defect Detection）

6. 回看检测结果（Review）——可联机或脱机查看检测结果

